

管理計画 (SOT-89) CONTROL PLAN (SOT-89)

トックス・セミコンダクター株式会社
TOREX SEMICONDUCTOR LTD.

代表例

| 工程記号 Flow | No. | 工程名 Process | 主な管理項目 Major item checked | 頻度 Frequency | プロセス Process |
|--------------|-----|---|--|---|------------------------------|
| ◇ | 1 | ウエハ受入 Wafer incoming | ロット番号, 員数照合 Lot No., Q'ty check | 抜き取り Sampling | ウエハ工程(外注) Wafer process |
| ○ | 2 | 酸化 Oxide | 時間, 温度 Temperature, Time | チューブ交換時 Tube change | |
| ◇ | 3 | 酸化膜チェック Oxide check | 外観, 酸化膜厚 Appearance・OX thickness | 抜き取り Sampling | |
| ◇ | 4 | チェック Check | 外観, 測定 Appearance・Measure | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 5 | フォト工程 Photo lithography | 品番照合 Against photo mask | 作業開始時 At Starting | |
| ◇ | 6 | チェック Check | 外観, 欠陥密度 Appearance・Defect density | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 7 | 拡散 Drive | 温度, 時間 Temperature, Time | 作業開始時 At Starting | |
| ◇ | 8 | チェック Check | シート抵抗, 酸化 Sheet resistance, Oxidation | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 9 | 金属膜形成 Metal deposition | 真空度 Vacuumness | 作業開始時 At Starting | |
| ◇ | 10 | メタルチェック Metal check | 外観, 厚み, 表面状態 Appearance, Thickness, Surface | 抜き取り Sampling | |
| ◇ | 11 | ウエハチェック Wafer check | 測定 Process Control Monitor | 抜き取り Sampling | |
| ◇ | 12 | ウエハテスト Wafer test | 電気的特性 Electrical characteristics | 100% | |
| ○ | 13 | レーザートリミング Laser trimming | レーザーパワー, トリミング箇所 Laser power, Location of shots | 作業開始時 At Starting | |
| ○ | 14 | ダイシング Dicing | 位置ずれ, フレート [®] の磨耗 Position, Blade Condition | 作業開始時 At Starting | 組立工程(外注) Assembly process |
| ○ | 15 | ダイアタッチ Die attach | 位置, 塗布量 Position, Amount of Coating | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 16 | ワイヤボンディング Wire bonding | 外観, 位置, ループ [®] , 引張強度 ボールシェア, ダイシェア Appearance, Position, Loop shape, Wire pull strength, Ball share strength, Die share strength | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 17 | モルディング Molding | 外観, X線検査 Appearance, X-ray check | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 18 | マーキング Marking | 外観 Appearance | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 19 | 鉛フリーはんだメッキ Pb-free Solder plating | メッキ厚, 液組成 Plating thickness, composition | 定期 Regularly check | |
| ○ | 20 | リードカット Lead cut | 寸法測定 Measuring dimensions | 抜き取り Sampling | |
| ◇ | 21 | 電気的特性検査 外観検査 テーピング Electrical test Visual check Taping | 電気的特性 マーク, リード テーピング強度 Electrical characteristics Mark, Lead Taping strength | 100% 100% 1回/日 100% 100% Per day | |
| ◇ | 22 | 出荷検査 Out going inspection | ラベル, 外観検査 Label, Appearance | 抜き取り Sampling | |
| ○ | 23 | 梱包出荷 Packing /Shipping | 伝票照合 Verification of product against slip | 1回/ロット Per lot | |